

課程名稱：印刷電路板佈局與製作 授課年級：電腦與通訊工程系 三年級

專業名詞英文 (字體大小 12pt)

編號	英文	中文	編號	英文	中文
1	SI(Signal Integrity)	信號完整性	26	DRC	電路圖設計規則
2	EMC	電磁相容性	27	Crystal	石英晶體
3	EMI	電磁干擾	28	Oscillator	振盪器
4	ESD	靜電放電防護	29	ATE	自動測試製具
5	ECC	偵錯檢正功能	30	Sheet	圖紙
6	CAD	電腦輔助設計	31	Via Swap	導孔對調
7	CAM	電腦輔助製造	32	Pin Swap	接腳對調
8	CAI	電腦輔助教學	33	Placement	零件佈局
9	AI	人工智慧	34	Routing	走線
10	PCB	印刷電路板	35	Copper	銅箔
11	via	導孔	36	Drill	鑽孔
12	FPC	軟性電路板	37	Tear Drop	淚滴
13	Zoom In	畫面放大	38	1 mil	千分之一英吋
14	Zoom Out	畫面縮小	39	Grid	格點
15	Edit Text	編輯文字	40	Board Outline	板框形狀
16	QFN	四邊扁平無接腳封裝	41	Simulation	模擬
17	Symbol Library	零件符號庫	42	Parameter	參數
18	Part Library	零件庫	43	Designator	序號
19	Component Library	零件外形封裝庫	44	Offset	偏差、偏移
20	Document Library	文件檔案庫	45	Initial Conditions	初值條件
21	Physical Layer	電氣特性的板層	46	Final Value	終值
22	Paste Layer	錫膏層	47	Netlist	網路清單
23	Solder Mask Layer	防焊層	48	Default	預設值、預設條件
24	Silk Layer	文字面	49	AC Small Signal Analysis	交流小訊號分析
25	Inner Layer	內層走線層	50	DC Sweep Analysis	直流掃瞄分析